

05; 06.1; 12

© 1993

## ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ДИФФУЗИЮ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИКЕЛЯ В КРЕМНИИ

Ф.М. Талипов, Р.Х. Хамидов

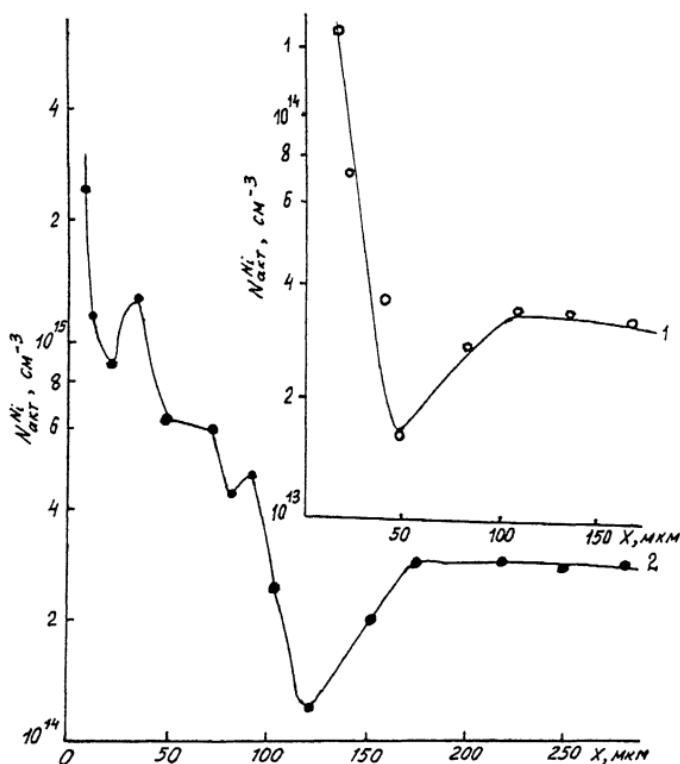
Легирование кремния никелем представляет большой научный и практический интерес в связи с возможностью повышения стабильности полупроводниковых приборов и интегральных схем на его основе к воздействию различных внешних факторов [1, 2]. Однако наличие в таком материале примесных микропключений никеля [3] может служить серьезным препятствием на пути внедрения материала в микроэлектронике. Установлено [4], что одним из путей устранения таких микропключений является воздействие всестороннего гидростатического давления, т.е. внешних упругих напряжений.

В данной работе исследовалось влияние внутренних упругих напряжений на диффузионный профиль и распределение никеля в кремнии.

Диффузия никеля проводилась из нанесенного в вакууме на поверхность образцов металлического слоя никеля при температуре  $1200\text{--}1250^{\circ}\text{C}$  в атмосфере аргона. Внутренние упругие напряжения в кремнии создавались также как и в [5] легированием его оловом. Предварительное легирование кремния оловом осуществлялось на стандартной установке выращивания кремния по методу Чохральского „РЕДМЕТ“. Концентрация олова в образцах п-типа с удельным сопротивлением  $8\text{--}13\text{ Ом}\cdot\text{см}$ , определенная методом нейтронно-активационного анализа, составляла  $5\cdot10^{17}\text{--}10^{18}\text{ см}^{-3}$ . Наряду с легированным оловом образцами использовались также образцы кремния без олова с аналогичными параметрами.

Концентрационный профиль распределения электрически активной части примеси никеля определялся методом диффузионного сопротивления, который заключается в многократном измерении поверхностного сопротивления диффузионного слоя с помощью 4-х зондовой головки при последовательном удалении тонких поверхностных слоев. Использовалась также методика ИК-микроскопии для изучения размеров и распределения микропключений никеля.

Полученный концентрационный профиль распределения электрически активной части примеси никеля в кремнии, легированном оловом, представлен на рисунке (кривая 1). Для сравнения там же приведен такой же профиль распределения в контрольном (без олова) образце кремния (кривая 2). Видно, что в контрольном образце наблюдается неоднородное распределение примеси никеля, что практически подтверждает результаты работы [6]. В образцах же кремния, легированного оловом, наблюдается резкий спад концентра-



Профиль распределения электрически активной части примеси никеля в легированном (1) и нелегированном оловом (2) образцах кремния.

ции никеля в приповерхностной области протяженностью 40–50 мкм и далее объемный участок имеет более пологую форму. Эти результаты можно объяснить также как и в [5] (для марганца) влиянием на диффузию никеля внутренних упругих напряжений, которые приводят к повышению энергетического барьера в процессе миграции атомов никеля по междоузлиям при его диффузии, т.е. повышением энергии активации диффузии примеси. В этом случае наблюдается торможение диффузионного потока в упругонапряженном слое, что приводит к эффективному увеличению растворимости никеля в кремнии, легированном оловом.

Исследования микровключений никеля по снимкам ИК-микроскопии (ИНФРАМ-4, увеличение в 5000 раз) показали, что в контрольных образцах образуются микровключения никеля размером в несколько микрон, что согласуется с литературными данными [3, 4]. В образцах кремния, легированного оловом, наблюдаются микровключения намного меньшего размера (приблизительно на порядок), и они более однородно распределены по объему кремния. С увеличением концентрации олова этот эффект усиливается.

В заключение можно сделать следующие выводы:

1. Наличие внутренних упругих напряжений в кремнии замедляет диффузию никеля в нем, что вероятно связано с повышением энергии активации диффузии никеля.
2. Изменяя концентрацию олова, создающего внутренние упругие напряжения, можно получать кремний, однородно легированный никелем.

### Список литературы

- [1] Талипов Ф.М., Бахадырханов М.К. // Электронная техника. Сер. 6. Материалы. 1985. В. 5 (204). С. 49-51.
- [2] Талипов Ф.М., Бахадырханов М.К. // Неорганические материалы. 1992. Т. 28. В. 2. С. 283-287.
- [3] Бахадырханов М.К., Талипов Ф.М. // Докл. АН УзССР. 1982. № 8. С. 28-30.
- [4] Зайнабидинов С.З., Тураев А.Р.; Фистуль В.И., Ходжаев М.Д. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 12. С. 2118-2121.
- [5] Бахадырханов М.К., Талипов Ф.М., Джуррабеков У.С. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 16. С. 77-79.
- [6] Бахадырханов М.К. Исследование физических явлений в кремнии, компенсированном элементами переходной группы железа и возможности его использования в полупроводниковой электронике. Автореф. доктор. диссер. Л., 1982. 35 с.

Ташкентский государственный  
университет

Поступило в Редакцию  
30 ноября 1992 г.